

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

## 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-4

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参会投资者清单。
时间	2026年7月7日-8日
地点	杭州、上虞
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 投资者关系 林婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司碳化硅衬底材料的扩产情况？</p> <p>答：在全球能源革命与半导体升级背景下，碳化硅（SiC）正加速向大尺寸升级，8英寸SiC衬底即将成为产业主流方向。公司子公司浙江晶瑞电子材料有限公司抢抓战略发展机遇，全面加速年产60万片8英寸SiC衬底项目投产，并启动建设新一期的基础设施，迎接未来AI、AR等新兴产业爆发式需求的到来。本次扩产项目实现无人化自动运行和数字化管控，保证车规级SiC晶片的质量稳定可靠性和全线可追溯性，建设成为行业领先的全自动智能工厂。</p> <p>2、请问公司碳化硅衬底材料的业务进展？</p> <p>答：公司以碳化硅衬底为核心，实现从技术突破到规模化供应的关键跨越。公司基于自主研发的碳化硅单晶生长炉以及持续迭代升级的8-12英寸长晶工艺，经过多年的技术攻关，创新晶体生长温场设计及气相原料分布工艺，攻克12英寸碳化硅晶体生长中的温场不均、晶体开裂等核心难题，实现了12英寸超大尺寸晶体生长的技术突破，成功建设12英寸碳化硅衬底加工中试线，并基于下游应用，向产业链客户进行送样验证。同时，积极推进8英寸碳化硅衬底在</p>

全球的客户验证，送样客户范围大幅提升，产品验证进展顺利，并成功获取海内外客户的批量订单，订单持续增长。光学级碳化硅材料布局成效显著，8 英寸产品工艺稳定并实现规模量产，12 英寸光学级碳化硅衬底研发取得突破并小批量生产。

3、今年以来，公司半导体设备业务进展？

答：受益于半导体行业持续发展及国产化进程加快，公司半导体业务持续发展。在集成电路装备领域，公司已构建 8-12 英寸半导体大硅片核心装备的全产业链布局，产品质量达国际先进水平，国内市占率领先；同时，延伸至芯片制造与封装环节，成功布局 8-12 英寸硅常压外延、8-12 英寸减压外延设备及减薄设备等，相关产品取得市场认可并实现批量销售。在化合物半导体装备领域，公司 6-8 英寸碳化硅外延设备、氧化炉、激活炉实现国产替代，市占率行业领先。今年以来，公司半导体大硅片设备、碳化硅设备、芯片制造设备业务进展顺利。

4、请介绍一下公司半导体大硅片设备？

答：在半导体大硅片设备领域，公司已构建 8-12 英寸半导体大硅片核心装备的全产业链布局，产品质量达国际先进水平，国内市占率领先。公司实现了 8-12 英寸半导体大硅片设备的国产替代，开发出了包括全自动晶体生长设备（直拉单晶生长炉、区熔单晶炉）、晶体加工设备（单晶硅滚圆机、截断机、金刚线切片机等）、晶片加工设备（晶片倒角机、研磨机、减薄机、抛光机）以及外延设备和清洗设备，且均已实现批量销售。

5、请问公司用于芯片制造的薄膜沉积设备业务进展？

答：今年，晶盛机电下属公司浙江求是创芯半导体设备有限公司多台先进制程核心薄膜沉积设备相继成功交付国内头部客户。本次交付的 12 英寸减压外延生长设备聚焦先进逻辑与特色硅光器件

	<p>两大核心领域，依托精准温场流程控制技术，实现高精度硅基薄膜沉积工艺，具备稳定性强、均匀性优异、缺陷可控等技术优势，能够全面满足硅光器件、先进逻辑、高端存储芯片的外延工艺需求，深度适配国产化先进晶圆制造工艺。</p> <p>6、请问公司半导体零部件的进展？</p> <p>答：子公司晶鸿精密坚持以核心零部件国产化为目标，不断强化精密加工、特种焊接、组装测试、半导体级表面处理等核心制造能力，持续加强关键零部件的研发攻关和产业化建设，产品质量持续提升，产品品类日益丰富。强化零部件产品的市场拓展，聚焦客户需求，构建研发、制造、服务一体化解决方案，为客户提供高品质、高效率的产品和服务，提升半导体产业链关键零部件的配套供应和服务能力，公司不断拓展真空腔体、精密传动主轴、游星片、陶瓷盘以及其他高精度零部件等系列产品的客户群体，推动市场规模持续提升。</p> <p>7、请问公司金刚石业务进展？</p> <p>答：公司长期聚焦半导体材料生长和加工的技术创新，金刚石晶体又称钻石，凭借其超宽禁带、高载流子迁移率、高击穿电场、高热导率以及优异的化学稳定性和机械性能，能够在极端条件下高效运行并解决传统半导体材料面临的诸多瓶颈问题，被誉为“终极半导体”材料。公司依托自研 MPCVD 设备与工艺，已实现高质量金刚石材料的稳定制备，并聚焦开发面向芯片散热的金刚石热沉片及面向光学系统的窗口材料，同时建设了大尺寸金刚石生产线，持续推动产业创新，促进公司新材料业务发展。未来公司将持续进行技术探索与产品开发，积极推动金刚石材料在更广泛极端环境下的解决方案，以支持前沿科技产业发展。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单

日期	2026年7月7日-8日
----	--------------

参会投资者清单

序号	公司
1	工银瑞信
2	泰康资产
3	长江证券
4	东吴证券